

技術詞彙表

本技術詞彙表載有本文件所用若干技術詞彙的解釋，該等詞彙與本公司及我們的業務有關。有關術語及涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法相符。

「5G」	指	第五代無線技術標準，旨在提供較前代移動網絡顯著更快的數據傳輸速度、更低的延遲及更強的連接能力
「先進製程」	指	具備更小幾何尺寸的新一代半導體製程節點，旨在實現更高性能、更低功耗及更高密度，但通常伴隨更高成本及複雜程度
「AEC-Q」	指	由汽車電子委員會(Automotive Electronics Council)制定的一套汽車質量及可靠性標準，用於認證汽車中使用的電子元件
「模擬模塊」	指	一種處理連續電信號的電路模塊，通常用於混合信號或傳感器應用中的放大、濾波或信號轉換
「BCD」	指	雙極型—CMOS—DMOS，為功率集成電路的關鍵製程技術。BCD為一系列硅製程，每一種均將三種不同製程的優點集成到單一芯片上：雙極型用於精準模擬，CMOS(互補金屬氧化物半導體)用於數字設計，而DMOS(雙擴散金屬氧化物半導體)用於功率及高壓元件
「位」	指	計算機計算中的最小數據單位，表示0或1的二進制值
「背照式圖像傳感器」	指	背照式圖像傳感器，具有光線從硅基板的背面進入以提高圖像傳感器靈敏度及性能的傳感器架構的CIS
「CIS」	指	互補金屬氧化物半導體圖像傳感器
「CMOS」	指	互補金屬氧化物半導體，結合負溝道(n溝道)與正溝道(p溝道)的集成電路
「CPU」	指	中央處理器，為計算系統中的主要處理單元，負責執行指令、管理系統運作，並協調硬件與軟件之間的任務
「晶格損傷」	指	半導體晶體原子排列的結構缺陷，可能影響器件性能

技術詞彙表

「客戶留存率」	指	於本年度／期間作出重複購買的上一年度／期間的客戶百分比
「DDIC」	指	顯示驅動芯片，一種芯片，負責處理信號及精確控制高級顯示面板運作
「EDA」	指	電子設計自動化，用於設計及驗證集成電路的軟件工具
「嵌入式非易失性存儲器」	指	集成在芯片內斷電後仍保留數據的存儲器
「全流程堆棧式CIS」	指	一種使用先進晶圓鍵合技術將像素層與邏輯處理層垂直堆疊的CMOS圖像傳感器架構，以提升圖像品質及性能
「GPU」	指	圖形處理器，為一種專用電子電路，旨在加速圖像與視頻的處理以及複雜數學運算，通常用於增強圖形渲染、支持AI應用以及提升整體計算效率
「高壓晶體管」	指	設計於高壓環境中運行的功率應用晶體管
「I/O接口」	指	輸入／輸出接口，為連接計算或控制系統與外部設備的通訊通道，實現數據輸入、輸出及信號交換
「IATF16949」	指	國際汽車工作組就汽車行業制定的全球質量管理標準，側重於持續改進、缺陷預防以及減少供應鏈變異及浪費
「集成電路」	指	集成電路，一種小型單元或封裝體，由不可分割的單一結構(如芯片)製成，在電學性能上等同於由多個獨立元件組成的傳統電路
「英寸」	指	英制長度單位，等於2.54厘米
「物聯網」	指	物聯網，收集及交換數據的互連設備網絡
「ISO14001」	指	由國際標準化組織(「ISO」)發布、規定有效環境管理體系要求的國際標準

技術詞彙表

「ISO45001」	指	由ISO發布、規定職業健康與安全管理體系要求的國際標準
「ISO9001」	指	由ISO發布、規定品質管理體系要求的國際標準
「LCD」	指	液晶顯示屏，利用電場調製液晶的顯示技術
「Logic IC」	指	用於執行邏輯運算及控制功能的集成電路
「成熟製程技術」	指	基於成熟的較早期技術節點的半導體製造方法，可提供高良率、穩定性及成本效益，而非追求領先性能
「MCU」	指	微控制單元，單一集成電路上的小型計算機，包含處理器核心、存儲器及可編程輸入／輸出外設
「微型OLED」	指	一種展示技術，將有機發光二極管集成至硅基板，實現高解析度、緊湊及節能的顯示方式
「多軌電壓調節」	指	一種自單一電源提供多個獨立電壓輸出(軌)的電源管理技術，以滿足處理器、存儲器及I/O接口等系統組件的多種電源需求
「nm」	指	納米
「OLED」	指	有機發光二極管，有機材料直接發光的顯示技術，與傳統顯示技術相比，可提供卓越的圖像品質、能效及設計靈活性
「OSAT」	指	半導體封測代工，負責半導體封裝及測試的第三方服務供應商
「PDK」	指	工藝設計套件，用於設計及模擬特定工藝半導體器件的檔案及模型集合
「光罩」	指	光刻中用於在晶圓上描繪電路圖案的工具
「光刻膠」	指	光刻中用於形成圖案的感光材料
「PMIC」	指	電源管理集成電路

技術詞彙表

「純晶圓代工企業」	指	專門從事為外部客戶設計的集成電路提供晶圓合同代工的專業半導體公司
「QC080000」	指	電子產品有害物質過程管理認證標準
「RF 芯片」	指	透過發送及接收無線電信號用以實現無線通信的射頻芯片，廣泛應用於移動設備、無線網絡及物聯網產品，以支持各類應用中可靠且高效的連接
「標準單元」	指	一種用於構建集成電路的邏輯電路塊
「系統級芯片(「SOC」)」	指	一種將CPU、GPU、存儲器及I/O控制器等多個電子組件整合至單一芯片的集成電路，可縮小尺寸、降低功耗及成本，同時提升性能
「技術節點」	指	以芯片關鍵特徵尺寸(以納米為單位)界定的特定半導體製造世代，代表製程微縮程度及性能提升
「熱氧化」	指	將硅晶圓暴露於高溫氧氣中，從而於其表面形成氧化層的過程
「晶體管」	指	用於放大或切換電子信號的半導體裝置
「晶圓」	指	半導體材料薄片，用於製造集成電路及其他微電子器件
「晶圓投產數」	指	投入生產流程的晶圓數目，用以衡量生產能力
「良率」	指	一批晶圓代工出功能正常器件的百分比
「 μm 」	指	微米，長度單位，等於百萬分之一米(10^{-6} m)